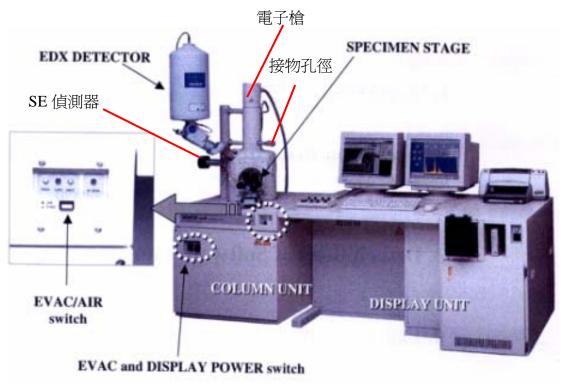
S-3000N 掃描式電子顯微鏡簡易操作手冊

(VERSION 1.2)



S-3000N 外觀圖

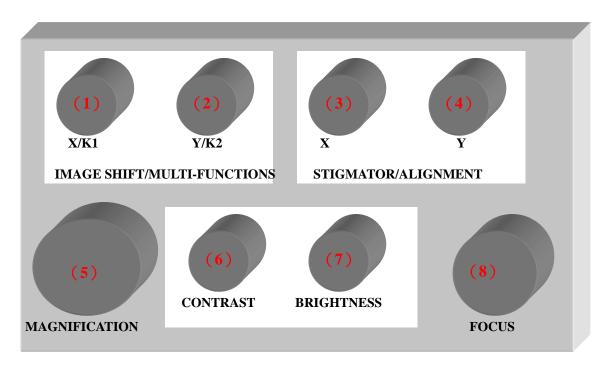
特性

- (A) 二次電子像解析度(SEI Resolution): 3.0nm。
- (B) 背向電子像解析度(BEI Resolution): 4.0nm。
- (C) 倍率(Magnification): $5\sim300,000$ 倍,能隨著加速電壓(Acc.V.)及工作距離(W.D)改變而自動校正。
- (D) 加速電壓(Accelerating Voltage): 0.5~30kV
- (E) 探針電流(Probe Current): 10⁻¹²~10⁻⁸A
- (F)可變真空掃瞄式之氣動閥全自動真空系統(真空値: 1~270 Pa 可調整),並可顯示真空讀値。
- (G) Chamber 大小:標準6吋樣品空間。
- (I) 樣品座移動範圍: X:80mm Y:40mm Z:5 to 35mm T:-20° to 90° R 360°

員 錄

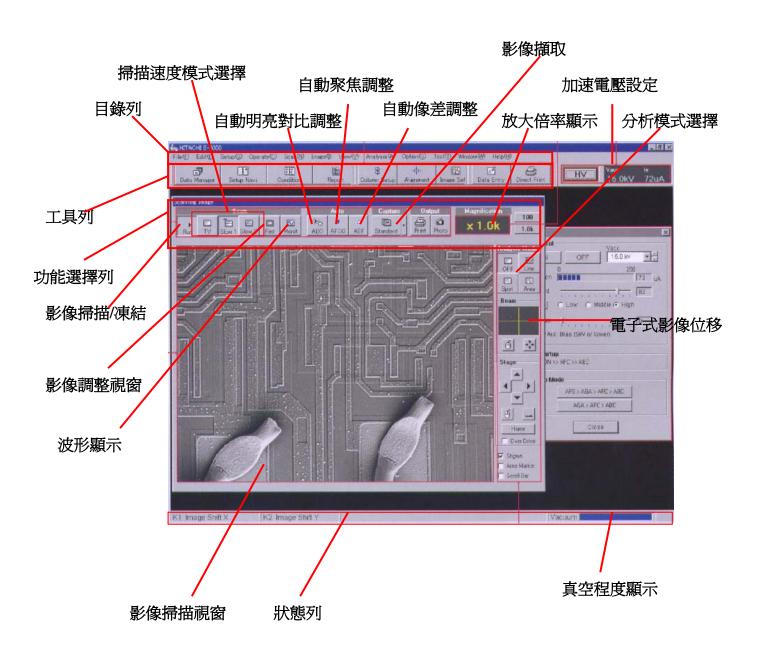
Ι	`	操作面板功能介紹	2
П	,	操作視窗介紹	3
Ш		開關機程序	
		(A) 開機程序	6
		(B) 關機程序	7
IV	•	樣品的置換	8
		(A) 放置樣品於樣品座上	8
		(B) 樣品的置入	8
		(C) 高真空模式設定	10
		(D) 低真空模式設定	11
V	,	影像的觀察	12
		(A) 加速電壓的設定	12
		(B) 影像亮度、對比調整	13
		(C) 焦距調整	13
		(D) 觀察區域的選擇	14
		(E) 像差的調整	14
		(F) 拍照攝影	15
VI	•	决定影像品質的因素	.16
		(A) 高真空模式下	
		(B) 低真空模式下	.17
VII	`	準位 (Alignment) 調整	.18
VIII	•	燈絲電流調整設定與電子槍的軸調整	.19

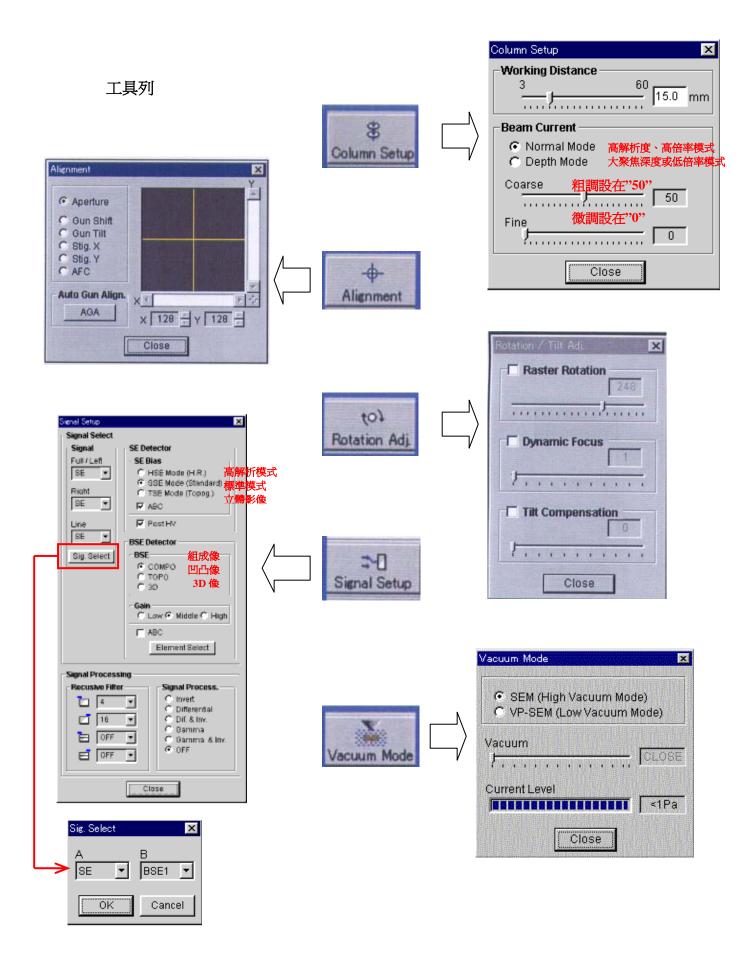
I、操作面板功能介紹

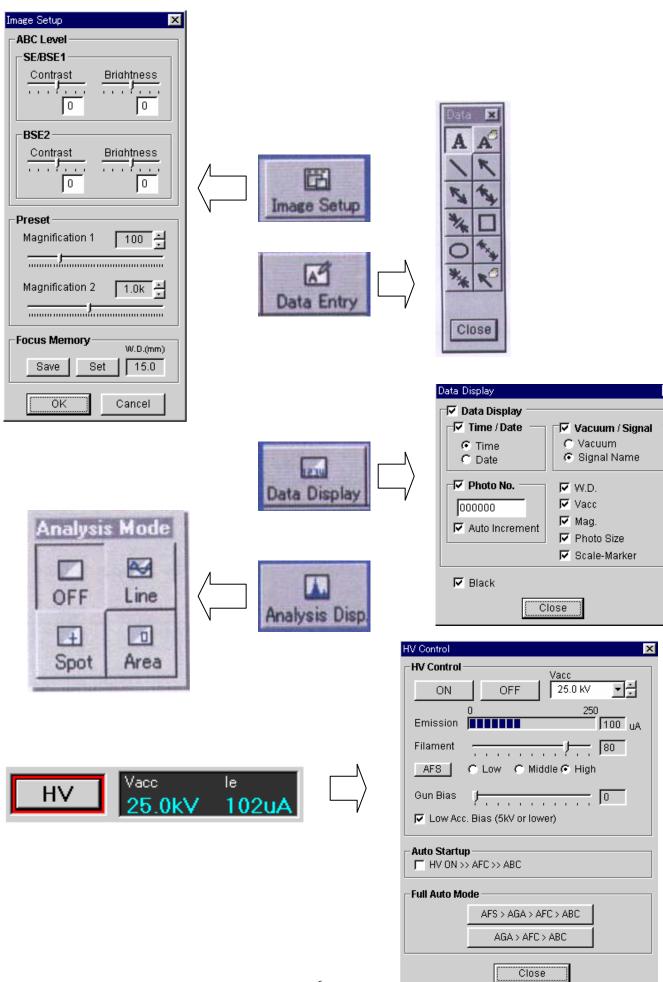


號碼	轉鈕	功能	
(1)	X IMAGE SHIFT/ K1 MULTI-FUNCTIONS	X 方向影像移動	
	(X影像移動/K1 多功能鈕)	K1 多功能影像調整	
(2)	Y IMAGE SHIFT/ K2 MULTI-FUNCTIONS	Y方向影像移動	
	(Y影像移動/K2多功能鈕)	K2 多功能影像調整	
(3)	X STIGMATOR/ALIGNMENT	X方向影像像差調整	
	(X像差調整鈕/軸調整)	電子束軸調整	
(4)	Y STIGMATOR/ALIGNMENT	Y方向影像像差調整	
	(Y 像差調整鈕/軸調整)	電子束軸調整	
(5)	MAGNIFICATION(倍率鈕)	影像縮小放大	
(6)	CONTRAST(對比鈕)	影像對比度調整	
(7)	BRIGHTNESS(明暗度鈕)	影像明暗度調整	
(8)	FOCUS (聚焦鈕)	影像焦距調整	

Ⅱ、操作視窗介紹







Ⅲ、開關機程序

(A) 開機程序



- (1) 打開冷卻循環水槽。
- * 確認水流量設定在1至1.5公升/分鐘的流量,水流量計在電子槍體之左側。
- (2) 打開 NFB(在配電盤上)主電源開關。

冷卻循 環水槽 開關

冷卻循環水槽



(3) 打開 EVAC POWER 真空系統電源開關, 打開後 RP 會開始運轉,真空操作面板上 的 LOW 指示燈及 WAIT 指示燈會亮。

EVAC POWER真空系統電源開關



真空操作面板

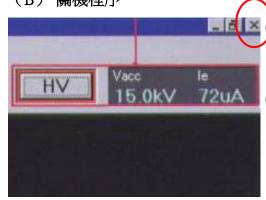
- (4) 將真空控制板上的 EVAC/AIR 按鍵, 押至 EVAC 位置。
 - *溫機大概約20分鐘左右,WAIT 燈會 熄滅,自動真空系統啓動,再等3分鐘之 後,LOW 指示燈熄滅,抽至高真空時 HIGH 的指示燈會亮。
- (5) 將操作系統的電源開關 DISPLAY POWER 開關打開。
- (6) PC 進入 Windows 2000 (profession. Workstation Version)版之操作系統。
- (7) 然後出現訊息指示"Press Ctrl+Alt+Delete to log on"出現在螢幕上,即按下Ctrl、Alt 和 Delete 鍵在鍵盤上同時按下。

(8) 上步驟(7)做完之後,下一步會進入 user name 及 Password,輸入正確的使用 者名稱及密碼註冊後,隨及進入操作書面。

使用者名稱:PC-SEM 碼:沒有設定

user name 和 password 設完成後將 OK 按下即可進入。





- 當有加速電壓 Vacc ON 時,將 HV 按下,把加速電壓關掉。
- (2)拉下File 視窗,選擇Exit,結束S-3000N 應用軟體(也可押右上角關閉)。

加速電壓開關



真空操作面板

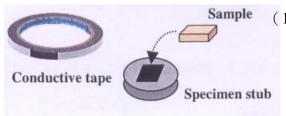


EVAC POWER真空系統電源開關

- (3) 然後按照一般電腦的軟體關機程序 (在 start 視窗中,選擇 shut Down (U) 會出現 "Shut down the computer"的訊 息時選 YES)之後會出現 "It is now safe to turn off your computer"的訊息 在螢幕上。
- (4) 真空控制面板選擇 EVAC 之位置,將 真空抽至 high(綠燈亮) 狀態。
- (5)先關掉 DISPLAY 開關後,再關 EVAC
 - *關機前請確認樣品已取出,及恢復高 真空狀態。
- (6) 關閉 NFB(在配電盤上)主電源開關。
- (7)等待約 30 分鐘,冷卻 diffusion 泵浦, 再關閉冷卻循環水。

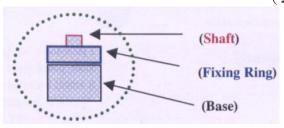
IV、樣品的置換

(A) 放置樣品於樣品座上



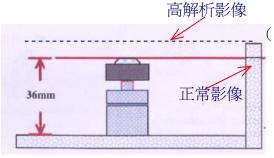
(1) 將樣品利用碳膠帶固定於樣品鋁 台上。

樣品準備



(2) 將樣品鋁台安置於樣品支撐座上。 *將固定環轉緊以避免樣品鋁台鬆 動。

樣品支撐座



(3)利用標準樣品高度計量器檢查樣品 高度。

標準樣品高度計量器

(B) 樣品的置入

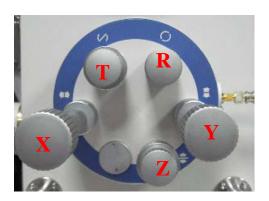


(1)當加速電壓在打開時,請確認 HV 是否關掉,若無將 HV OFF。

加速電壓關閉



(2) 在真空控制板上 EVAC/AIR 按鍵, 按下至 AIR,此時 LOW 的指示燈 亮,真空室內進入空氣,樣品室將 會破真空。



樣品座



樣品座的凹槽

Vacuum

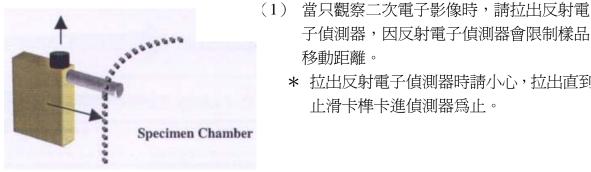
真空計狀態

- (3) 一段時間後就可以拉出樣品座。
 - *在拉出樣品座前,請確認每一個樣 品座旋鈕的位置:

X=30mm Y=20mm $T=0^{\circ}$ Z=EX R=as desired

- (4) 把做好的樣品,放入樣品座的凹槽中。
- (5) 把樣品座推回 Chamber 中,然後按下 EVAC/AIR 的 EVAC 設定。
 *如果背向電子偵測器已放入,請確認 Z 軸(工作距離)設定在 15~35mm, T 軸在 0 度,再推回樣品座。
- (6) 等待大約 3~4 分鐘,抽到 HIGH 高真空指示燈亮起。
- (7) 真空達到時,真空計狀態會變成藍色,在工具列中 HV 鍵會出現,並可被選擇加速電壓設定

(C) 高真空模式設定(樣品爲導電物質或表面有鍍金,可做高解析影像) 高真空模式可觀察二次電子(SE)影像與反射電子影像(BSE)。



- 子偵測器,因反射電子偵測器會限制樣品 移動距離。
 - * 拉出反射電子偵測器時請小心,拉出直到 止滑卡榫卡進偵測器爲止。

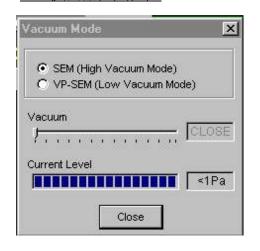




放入BSE偵測器位置

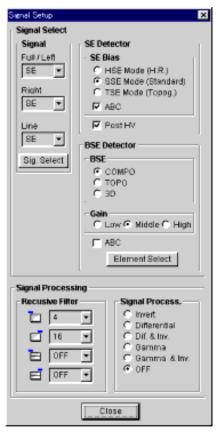


BSE偵測器拉出位置



- (2) 觀察背向電子影像時,放入 BSE 反射電子 偵測器。鬆開固定旋鈕,拉起止動桿,小心 放入 BSE 偵測器。
 - *放入BSE 反射電子偵測器前,請確認工作 距離爲 15~35mm 之間,頃斜角度 0°,主 要是保護 BSE 反射電子偵測器,避免碰撞 **危害**。
 - *完全放入BSE 偵測器,觀察的是組成像 (composition image)和凹凸像 (topographic image);如果只放入一半, 觀察的是 3D 像。此時請固定固定旋鈕, 在觀察凹凸像時,請把工作距離爲 15~35mm 之間。

(3) 在 Vacuum Mode 視窗中選擇 SEM (High Vacuum Mode) 高真空模式。

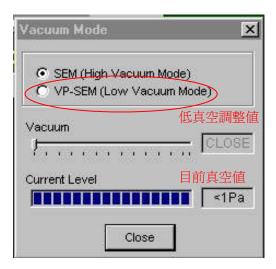


(4)在 Signal Setup 視窗中,選擇影像的訊號來源偵測器、雙倍率的右邊、線分析和指定訊號源。

*如果要看二次電子影像,請確認 Post HV 後段加速電壓要打開。

Signal Setup視窗

(D) 低真空模式設定(樣品為非導體或無經過表面處理,可以避免電荷累積) 在低真空模式只能觀察 BSE 反射電子影像,二次電子偵測器是無法使用 的。



vacuum mode 視窗

- (1)在 Vacuum Mode 視窗中,設定為 低真空模式 (VP-SEM)並調整爲適 當的真空値。在真空控制面板上 N-SEM 指示燈會亮起。
 - *實際真空值調整與設定一致,大約需要兩分鐘。
- (2) 放入 BSE 反射電子偵測器。 *放入 BSE 反射電子偵測器前, 請確認工作距離爲 15~35mm 之 間,頃斜角度 0°,主要是保護 BSE 反射電子偵測器,避免碰撞 危害。
- (3) 用完時,請將 BSE 反射電子偵測器拉出,並將真空設定選擇 High vacuum Mode。
- *在作高低真空切換時,請將 HV 加 速電壓關閉。

V、影像的觀察

(A) 加速電壓的設定

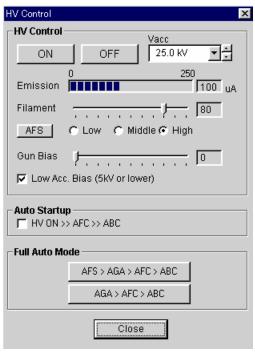


加速電壓開啓

- (1) 按下 HV 按鍵,打開加速電壓。 (再押一下爲關閉加速電壓)
 - * 紅色爲 ON,沒有顏色爲 OFF,其 加速電壓值與電流值會顯示在旁。



電壓與電流值顯示視窗



(2)依照樣品種類、分析目的及解析 度要求更改電壓設定值。在 HV Control 視窗中,拉下 Vacc.下拉視 窗設定加速電壓。

HV Control視窗

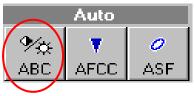


加速電壓與放射電流值顯示視窗

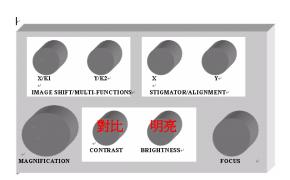
(3)請確認加速電壓與放射電流值顯示。

(B) 影像亮度、對比調整

自動明亮 對比調整



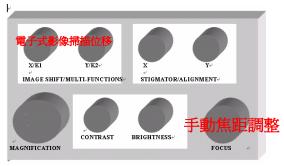
自動調整視窗



操作面板

(C) 焦距調整

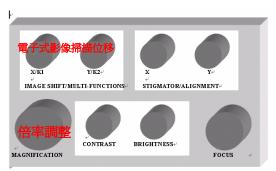




操作面板

- (1) 自動:按下 ABC 自動調整,調整影像會凍結而螢幕上出現 "ABC mode in process"的訊息,當蜂鳴聲響起時,螢幕又回復到掃描影像時,自動調整完成,此時影像所呈現的對比與亮度,就是自動調整後的結果。 *如果一次仍無法達到最佳狀況,可以再選 ABC 數次。如果要更改 ABC 的設定,可在 Image Setup 功能中進行。 *如果 ABC 一直無法達到理想效果,可能是因爲樣品表面太平滑,此時請利用手動來調整。
- (2) 手動:使用 BRIGHTNESS & CONTRAST 調整旋鈕,調整影像適當的亮度與對比。 *可利用選擇波形顯示,螢幕會出現訊號波形,請將波形的最高與最低的地方,調整到上下各兩條間帶之中即可,此時就是最佳的明暗與對比
- (1) 自動:壓 AFCC 自動調整啓動,進行期間影像會被凍結,螢幕上會出現 "A.F.C. Mode In Process" 的訊息,當結束後會有蜂鳴聲提醒使用者,且自動調整後影像會回到掃描狀態。
 - * 自動焦距調整有時會因樣品狀態平滑缺乏對比而失敗,請改用手動操作。
 - * 如果自動聚焦功能不理想,請 先做孔徑準位與燈絲準位的調 整
- (2) 手動:一邊使用聚焦調整旋鈕, 一邊觀察影像調整的結果。

(D) 觀察區域的選擇:



操作面板

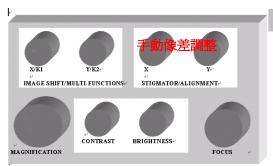


倍率顯示視窗

(E) 像差的調整



- (1) 首先把放大倍率放到最低,然後用 樣品座上的 X、Y、Z、R 旋鈕找到 欲觀察的區域,然後逐次加放大倍 率,直到最適當爲止。
- (2) 當在放大倍率時(幾千倍或更高),這 時可使用電子式影像掃描位移 IMAGE SHIFT,此時可使用電子式 影像掃描位移旋鈕 X、Y。
 - * 電子式影像掃描位移在工作距離 15mm 時,大約可做最大有 $+/-20 \mu$ m X,Y 方向的位移,如需更多請使 用樣品座上的旋鈕來調整。
- (1) 自動:壓 ASF 像差自動調整啓動, 進行期間影像會被動凍結,而螢幕 上出現"A.S.F Mode In Process"的 訊息,當結束後會有蜂鳴聲提醒使 用者,且自動調整後的影像會回到 掃描狀態顯示。
 - * 自動像差調整,有時會因樣品表面 狀態平滑缺乏對比而失敗,請改用 手動操作。
 - * 在進行像差調整前,聚焦一定要先 做好,否則結果是不正確的。
 - * 如果像差自動調整失敗,請先進行 孔徑準位與燈絲準位的調整。



操作面板

(2) 手動:一邊觀察影像,一邊調整 STIGMATOR X,Y 旋鈕,觀察結果。 *有時會因為軸偏移或孔徑污染而造 成像差無法調整,此時可先進行軸調 整與更換孔片。

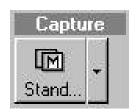


註:調整聚焦與像差時可以利用縮小掃描 區域(Reduced Area Scan)來輔助。

更改掃描速度

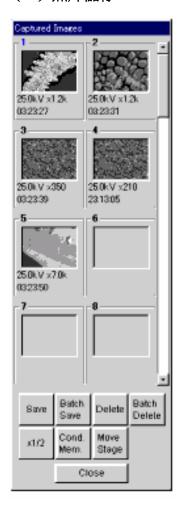
掃描選擇視窗

(F) 拍照攝影



影像擷取

(G) 照片儲存



(1) 在成像的畫面直接按壓 Capture 按 鍵,進行其間在螢幕上出 現 "Capture" 畫面,結束後會把所 需的畫面擷取下來,並完成拍照程 序。

(1) 擷取的影像會放在如左圖的視窗中,選 擇欲儲存的影像後,按下下方的 SAVE

> Save ,選擇欲存放的資料夾,輸入 檔案名稱則完成儲存。

Batch Save : 儲存多張照片

Batch

Delete :刪除照片

Delete :刪除多張照片

x1/2 :擷取的影像以原視窗比例縮小 1/2

Cond. : 儲存影像 SEM 機台條件

VI、決定影像品質的因素

(A) 高真空模式下

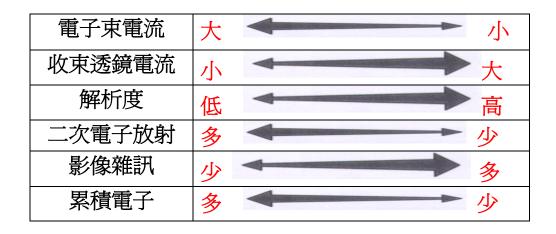
(1) 設定加速電壓

如下表說明加速電壓與影像品質之間的關係,請依需要選擇適合的加速電 壓。

加速電壓	低。一高
解析度	低 高
累積電子	少多
二次電子放射	多少少
樣品污染	增加 減少
樣品損害	減少 增加
影像品質	軟 硬

(2) 設定電子束電流

如下表說明電子束電流與影像品質之間的關係,請依需要選擇適合的電子束電流。



(3) 選擇接物孔徑的大小

如下表說明接物孔徑的大小與影像品質之間的關係,請依需要選擇適合的接物孔徑的大小。

	1	2	3	4
孔徑開孔 直徑	150 μ m	80 μ m	50 μ m	30 μ m
聚焦深度	更淺	淺	深	更深
解析度	更低	低	高	更高
放射電流	很高	高	較低	低

(4)工作距離

工作距離爲樣品觀察表面到接物鏡頭之間的距離。工作距離的調整主要是 靠樣品座上 Z 軸的長短。如下表說明工作距離與影像品質之間的關係, 請依需要選擇適合的工作距離。

工作距離	長 短
聚焦深度	深
解析度	低 善高

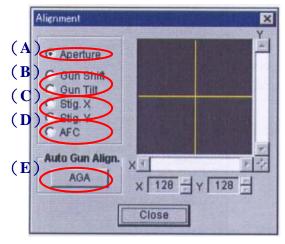
(B) 低真空模式下

真空程度	1Pa 270Pa
產生正離子數	少多
累積電子	多 少
二次電子放射	少多
背向散射電子	多 少
含水樣品的脫水	快 慢

VII、準位(Alignment)調整

調整電子束準位時使用,利用 STIGMATOR/ALIGNMENT X、Y 轉鈕進行調整。

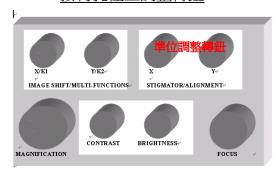




電子束準位調整視窗



接物孔徑上調整轉鈕



操作面板

(A) 孔徑 (Aperture)

調整接物孔徑準位時使用,此時影像會做頻率性跳動,調整接物孔徑 上調整轉鈕,使影像作最小的跳動,此時 X、Y 數值沒有任何意義。

- (B)電子槍位移(Gun Shift)、電子槍傾斜(Gun Tilt)軸向準位的調整,可使電子束正確的進入接物孔徑,請利用STIGMATOR/ALIGNMENT X、Y轉鈕重複調整電子槍位移、電子槍傾斜 X、Y 位置,而使畫面的亮度達到最亮即可。
- (C) 像差 X (Stig X)、像差 Y (Stig Y) 調整影像最小的偏移,此時影像會做頻率性跳動,利用 STIGMATOR/ALIGNMENT X、Y 轉鈕,調整 X、Y 的位置,使影像作最小的跳動,此調整可使 ASF 有較佳的正確性。

(D) AFC

此調整可使自動聚焦功能有較佳的 正確性,利用 STIGMATOR/ALIGNMENT X、Y 轉鈕,調整 X、Y 的位置,使影像 作最小的移動。

(E) AGA(自動電子槍準位) 按下 AGA 按鍵,影像會暫時凍結, 幾秒鐘後會有短暫鳴聲表示準位已 調整結束。此時電子束會正確通過 接物孔徑,影像回復到正常掃描。 如果是長蜂鳴聲時,表示自動電子 槍準位調整失敗。

Ⅷ、燈絲電流調整設定與電子槍的軸調整

當燈絲更換之後,燈絲電流必須重新調整設定,電子槍的軸調整也必須重新執行。



- (1) 請檢查於真空控制面板上,代表高 真空的綠燈是否亮起,而且 HV 在 工具列出現,真空顯示部分爲正常 藍色條狀顯示。
- (2) 按下 HV 啟動加速電壓

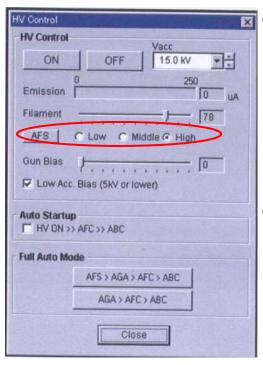
真空控制面板



HV 顯示視窗



真空顯示



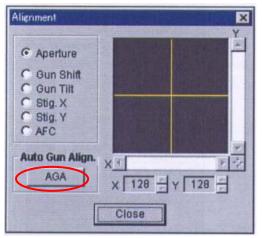
HV Control 視窗

- (3) 接下 HV Control 視窗之中的 AFS 鍵 (選擇 High)。當按下燈絲電流自動 控制時,影像會暫時凍結,此時有 關訊息指示會出現。
 - * Low:延長燈絲壽命模式

Middle:標準模式

High: 高倍率高解析模式

(4) 檢查放射電流是否有讀值。



(5)選擇 Alignment 視窗,然後按下 AGA 自動執行調整影像會暫時凍結,幾秒 鐘後會有短暫鳴聲表示準位已調整結束,此時有關訊息指示會出現,影像 回復到正常掃描。